

## Cintillo Legal

Revista Electrónica de Ingeniería y Aplicación (REIA), Año 7, No 7, Septiembre 2023, es una publicación anual editada por el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, a través de las divisiones de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Domicilio Conocido S/N, El Saucillo, Huichapan, Hidalgo, CP 42411, Tel. 7617248080, [www.iteshu.edu.mx](http://www.iteshu.edu.mx). [iteshu@iteshu.edu.mx](mailto:iteshu@iteshu.edu.mx) , editor responsable: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2022- 090915033800-102, ISSN 2448-6817, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Responsable de la última actualización de este número, Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, Domicilio Conocido S/N, El Saucillo, Huichapan, Hidalgo, CP. 42411, Municipio de Huichapan, estado de Hidalgo. Fecha de última modificación: 15 de diciembre de 2023.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.